

Solution de boîtier flexible pour les environnements sévères

PROTECTION IP67 POUR L'ÉLECTRONIQUE SENSIBLE



Le boîtier en aluminium moulé sous pression proposé par **nVent SCHROFF** bénéficie d'un indice de protection IP 67, d'un blindage CEM, ainsi que d'une tenue aux chocs, aux vibrations et à la corrosion.

Il est compatible avec les facteurs de forme standard ou spécifiques clients utilisés dans l'électronique. La gamme de boîtiers bénéficie de toute l'expertise **nVent SCHROFF** qui englobe des solutions innovantes pour la fixation des cartes, la gestion des câbles et un concept de refroidissement optimal.



CONCEPTION SUR MESURE POUR CHAQUE APPLICATION

Configuration d'une solution de boîtier flexible

Les 15 différentes dimensions disponibles, les possibilités de découpes personnalisées, ainsi que les solutions de fixation de cartes et de gestion des câbles, permettent de couvrir de nombreuses applications.

Concept de refroidissement optimal

Le refroidissement par convection et conduction permet la dissipation de la chaleur via le boîtier lui-même et peut être adapté à chaque application.

Protection de l'électronique pour utilisation en intérieur et extérieur

- Ferroviaire et transports
- Communications
- Tests et mesures
- Internet industriel des objets (IIoT)

Simulations et tests

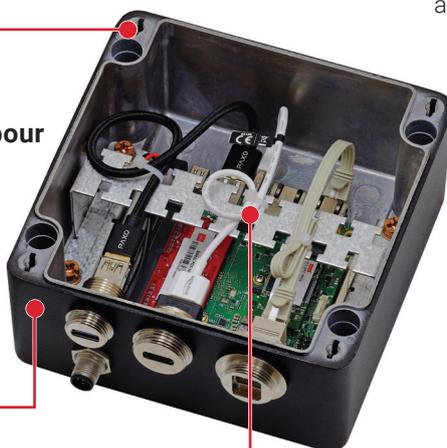
Les simulations thermiques et les tests IP ou CEM garantissent la fonctionnalité du boîtier.

Design esthétique du boîtier

Conception attrayante du boîtier par poudrage, sérigraphie ou impression numérique avec une excellente tenue des couleurs aux influences environnementales ou aux produits chimiques.

Développement et intégration des composants électroniques

Solutions personnalisées du câblage jusqu'aux services d'intégration, en passant par les cartes telles que les COM Carrier.



Le produit présenté ci-dessus est un boîtier CEM, de dimensions 160 x 160 x 90 mm, intégrant une carte Embedded NUC™.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Boîtier disponible dans de nombreuses dimensions

- 15 différentes dimensions, à partir de 50 x 45 x 30 mm jusqu'à 600 x 310 x 180 mm

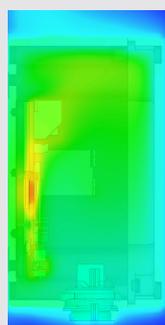
Haute résistance aux influences environnementales

- Jusqu'à IP 67 selon NF EN 60529
- Plage de température du boîtier : -55 à +125°C
- Tenue à la corrosion : sévérité A (NF EN 62208/9.13.2.1) et sévérité B (NF EN 62208/9.13.2.2), en fonction du revêtement

Protection fiable, même en cas de sollicitations physiques

- Tenue aux chocs IK 09 selon CEI 62262
- Résistance aux chocs et vibrations selon EN 50155 (tests en cours)

SIMULATIONS THERMIQUES ET TESTS CEM



Température (°C)



nVent SCHROFF réalise des simulations thermiques dès les premières phases de développement du boîtier afin de garantir le concept de refroidissement le mieux adapté à l'application.

Test avec refroidissement par conduction (illustration de gauche) :

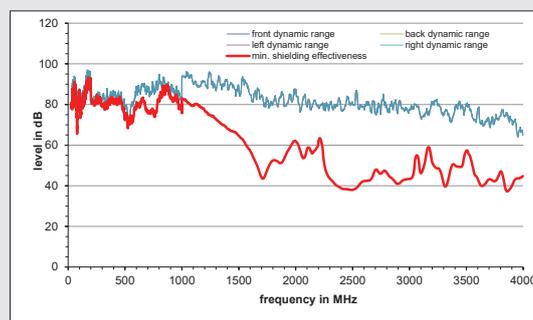
- Processeur : Intel® Core™ i7, processeur de la 10^e génération (mobile)
- Puissance dissipée par le processeur : 15 W
- Température ambiante : 30°C
- Fixation du boîtier sur un mur isolé
- Taille du boîtier : 160 x 160 x 90 mm

Excellentes caractéristiques CEM

Le blindage CEM garantit un fonctionnement fiable des composants électroniques intégrés dans le boîtier.

Test réalisé avec un boîtier de 330 x 230 x 110 mm, pour une plage de fréquences entre 30 MHz et 4 GHz.

Le graphique de droite montre le scénario le moins favorable ; la performance du boîtier peut être aisément améliorée en y apportant quelques modifications mécaniques.



EUROPE

Allemagne

Tél. +49.7082.794.0

France

Tél. +33.3.88.90.64.90

Pologne

Tél. +48.22.209.98.35

Assago, Italie

Tél. +39.02.5776151

AMÉRIQUE DU NORD

Tous Les Sites

Tel +1.800.525.4682

MOYEN-ORIENT ET INDE

Émirats Arabes Unis

Tél. +971.4.37.81.700

Inde

Tel +91.80.67152001

Turquie

Tél. +90.216.250.7374

ASIE PACIFIQUE

R.P. Chine

Tél. +86.21.2412.6943

Qingdao, R.P. Chine

Tel +86.523.8771.6101

Singapour

Tel +65.6768.5800

Japon

Tel +81.45.476.0271



Notre vaste portefeuille de marques :

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER